

DIN-Rail CPU 60

Eigenschaften:

- i.MX536 SODIMM Prozessormodul
 - Freescale i.MX536 Cortex-A8 CPU
 - 800MHz CPU Clock
 - 512 MByte DDR3-RAM
 - 8 MByte NOR-Flash
 - 4 GByte NAND-Flash
- 2x 12 Bit delta-sigma ADC Input
- 2x 8 Bit DAC Output (0–10V)
- 4x digital Input
- 3x RS485, 1x CAN, 2x RS232
- 1x 10/100 Base-T-Ethernet-Port
- Je 1x UART für Uplink und Downlink
- 1x RS485 über BUS-Connector
- 2x USB Schnittstelle (1x Host, 1x Device)
- Temperaturbereich: -10°C bis +70°C
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Hutschienengehäuse: 6TE
- Modulares System, beliebig erweiterbar
- Weitere Hutschienen-Module erhältlich
z.B. Motorcontroller (9TE), DIN-Rail ADDA 6140 (6TE), DIN-Rail Relais 616S (6TE), DIN-Rail CPU 10 (1TE), DIN-Rail CPU 61 (6TE)
- Alle Module können über UART und RS485 miteinander kommunizieren
- einfache Verbindung der einzelnen Module über passende Busverbinder möglich
- Linux Betriebssystem, BSP mit Toolchain + Quellen werden frei mitgeliefert

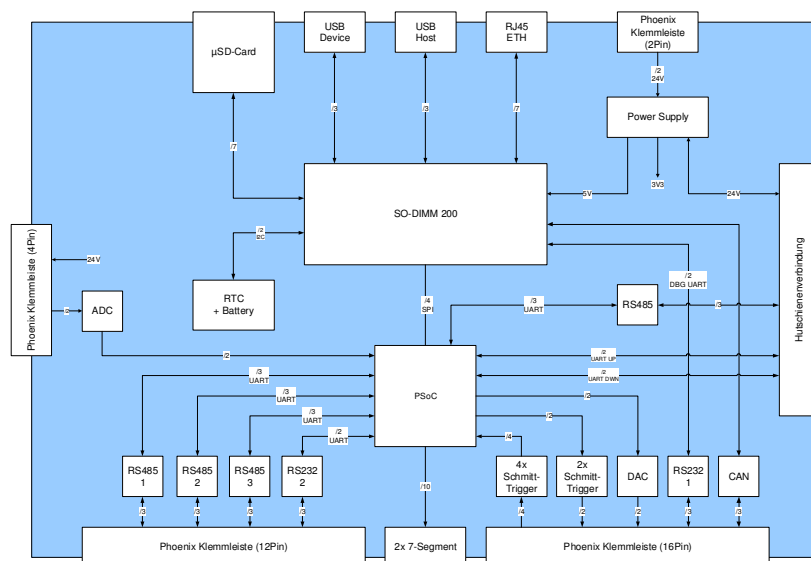


Abbildung 1: Blockschaltbild

Anschlussbelegung:

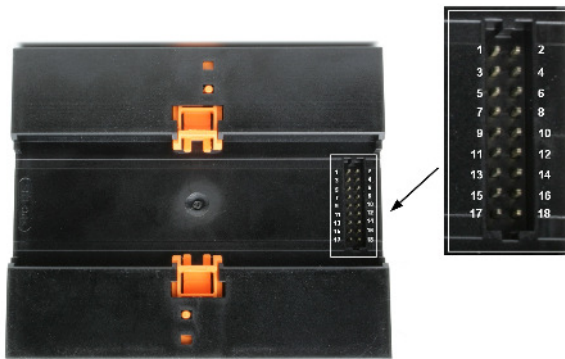


Abbildung 2: Pinbelegung BUS Connector

BUS-Connector:

1 – NC	2 – NC
3 – +24V	4 – +24V
5 – GND	6 – GND
7 – RS485 A Host (ttyU0)	8 – RS485 B Host (ttyU0)
9 – GND	10 – GND
11 – NC	12 – NC
13 – GND	14 – GND
15 – UART4 TXD	16 – UART3 RXD
17 – UART4 RXD	18 – UART3 TXD

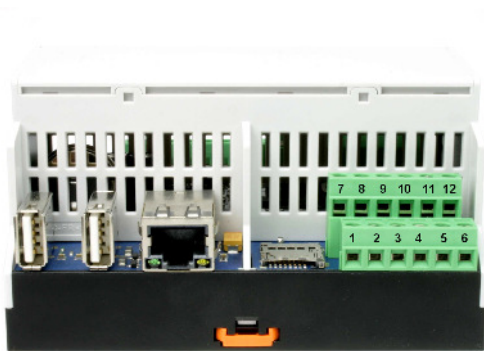


Abbildung 3: Pinbelegung Vorderseite

J1:

1 – RS485-A_2 (ttyU2)	7 – RS485-A_1 (ttyU1)
2 – RS485-B_2 (ttyU2)	8 – RS485-B_1 (ttyU1)
3 – GND	9 – GND
4 – RS485-A_3 (ttyU3)	10 – TX_2 RS232 (ttyU4)
5 – RS485-B_3 (ttyU3)	11 – RX_2 RS232 (ttyU4)
6 – GND	12 – GND



Abbildung 4: Pinbelegung Rückseite

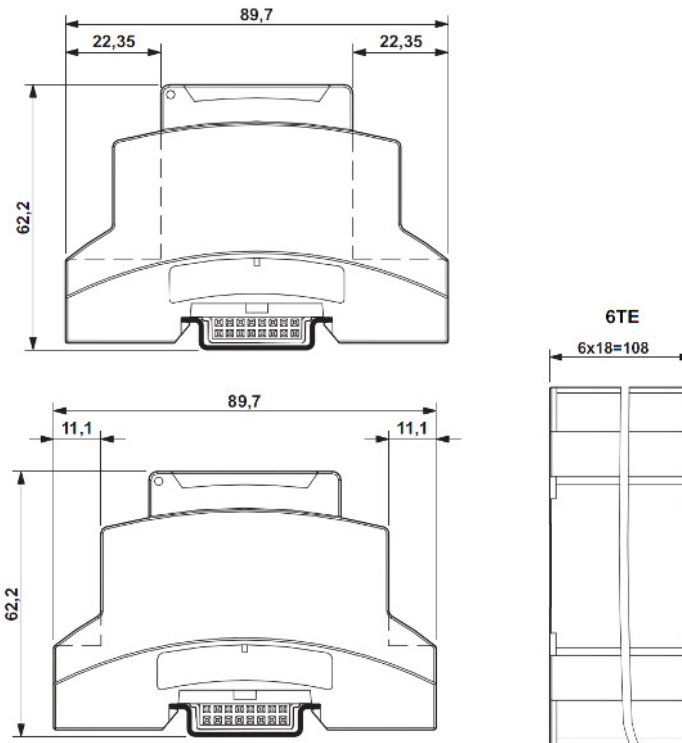
J2:

1 – CAN_L	9 – TX_1 RS232 (DBG UART)
2 – CAN_H	10 – RX_1 RS232 (DBG UART)
3 – GND	11 – GND
4 – DIG_IN_4 (GPIO 255)	12 – DIG_OUT_2 (GPIO 250)
5 – DIG_IN_3 (GPIO 254)	13 – DIG_OUT_1 (GPIO 249)
6 – DIG_IN_2 (GPIO 253)	14 – GND
7 – DIG_IN_1 (GPIO 252)	15 – DAC_OUT_1
8 – GND	16 – DAC_OUT_2

Pinliste i.MX536 SODIMM:

TBD

Maßzeichnung:



Kontakt

In-Circuit GmbH
Königsbrücker Str. 69
D-01099 Dresden
www.in-circuit.de
info@in-circuit.de

Bestellinformationen			
Beschreibung	Artikelnummer	Verpackung	Mindestbestellmenge
DIN-Rail CPU 60 - i.MX 536 CPU Modul, 6TE	901.249B	ESD-Tüte, Luftpolster	1
DIN-Rail CPU 10 - SAM9G45 CPU Modul, 1TE	901.212	ESD-Tüte, Luftpolster	1
DIN-Rail CPU 61 - i.MX 536 CPU Modul, 6TE	901.033	ESD-Tüte, Luftpolster	1
DIN-Rail ADDA 6160 - 6x ADC Input, 4x DAC Output 0-10V, 6TE	901.218	ESD-Tüte, Luftpolster	1
DIN-Rail Relais 616S - 6x Relais Schaltausgang, 4x Digitaleingang, 6TE	901.214	ESD-Tüte, Luftpolster	1
Busverbinder 1TE 2Slot - zur Verbindung von 1TE Modulen	303.061	ESD-Tüte, Luftpolster	1
Busverbinder 6TE 2Slot - zur Verbindung von 6TE Modulen	303.062	ESD-Tüte, Luftpolster	1
Micro SD-Karte 1GB - passende µSD-Karte für CPU Module	104.042	ESD-Tüte, Luftpolster	1

Änderungsliste

Version	Datum	Änderungsgrund	Bearbeiter
A	05.09.2013	Erstausgabe	Träger